45　周波数変換器であって、次の⑴又は⑵に該当するもの（別表第１に掲げるものを除く。）
⑴　次のア及びイに該当するもの
ア　40ワット以上の出力を得ることができるもの
イ　出力が二相以上のものであって、周波数が600ヘルツ超2,000ヘルツ未満の出力を得ることができるもの
⑵　周波数が300ヘルツ超600ヘルツ未満の出力を得ることができるもの
46　アルミニウム合金（鍛造したものを含む。）であって、引張強さが20度の温度において415メガパスカル以上となるもののうち、外径が75ミリメートル以上の棒又は円筒形のもの（別表第１に掲げるものを除く。）
47　炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維又は炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維を用いたプリプレグであって、次のいずれかに該当するもの（別表第１に掲げるものを除く。）
⑴　炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維であって、次のア及びイに該当するもの
ア　比弾性率が3,180,000メートルを超えるもの
イ　比強度が76,200メートルを超えるもの
⑵　⑴に該当する繊維に熱硬化性樹脂を含浸したプリプレグであって、次のア及びイに該当するもの
ア　繊維状のもの
イ　幅が30ミリメートル以下のテープ状のもの
48　レーザー溶接機（別表第１に掲げるものを除く。）
49　数値制御を行うことができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が４若しくは５のもの又は放電加工をすることができるもの（別表第１に掲げるものを除く。）
50　プラズマ切断機（別表第１に掲げるものを除く。）
51　金属水素化物（別表第１に掲げるものを除く。）
52　高分子化合物であって、次のいずれかに該当するもの
⑴　末端に水酸基を有するポリエーテル（別名ＨＴＰＥ）
⑵　末端に水酸基を有するカプロラクトンエーテル（別名ＨＴＣＥ）
⑶　ポリプロピレングリコール（別名ＰＰＧ）
⑷　ポリグリコール酸（別名ＰＧＡ）
⑸　ポリエチレングリコール（別名ＰＥＧ）
53　ミサイル防衛に係る対抗措置サブシステム及び侵入支援装置であって、ミサイル防衛システムを飽和させ、混乱させ、又は当該ミサイル防衛システムから逃れるよう設計したもの（例えば、ジャマー、チャフ又はデコイ）
54　金属マンガンのろう付けはく
55　水圧加工装置
56　熱処理炉（850度を超える温度において使用することができるものであって、寸法が１メートルを超えるものに限る。）
57　摩擦かくはん接合装置
58　ロケット又は無人航空機の空気力学分析及び熱力学分析のためのモデルに関連する技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体
59　高速度の撮影が可能なカメラ又はこれを用いた装置（別表第１、別表第２及び別表第３並びにこの表の１から７まで、23から28まで及び38に掲げるもの並びに医療用の画像システムにおいて使用されているものを除く。）
60　６以上の車軸を有するトラックのシャシ
61　次のいずれかを内容とする情報が記載若しくは記録された文書、図画又は記録媒体
⑴　次のいずれかに該当する物資を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。以下61において同じ。）
ア　500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は４⑵に該当する物資の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品
イ　４⑴イ又はウのいずれかに該当する物資
⑵　４⑵エからキまで若しくは17のいずれかに該当する物資を操作し、保守し若しくは点検するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術
⑶　500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機を使用するために設計したプログラムであって、２つ以上の物資（４に該当するものに限る。）の機能を調整することができるもの又はその設計、製造若しくは使用に係る技術
⑷　４⑴に該当する物資の製造用の装置、工具、試験装置若しくはこれらの部分品を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術
⑸　500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくはその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品又は４に該当する物資の設計、製造又は使用に係る技術
⑹　５⑴から⑼までのいずれかに該当する物資の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同⑴、⑵、⑺、⑻若しくは⑽、６、８、９、23（⑻を除く。）、24から29まで、33⑴、34、35若しくは38（⑹を除く。）のいずれかに該当する物資を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術
⑺　ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機（500キログラム以上のペイロードを運搬することができるものを除く。）又は５、６、８、９まで若しくは11から41まで（23⑻及び38⑹を除く。）のいずれかに該当する物資の設計、製造又は使用に係る技術
⑻　５⑵、⑶、⑸若しくは⑹若しくは６のいずれかに該当する物資を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術
⑼　12から16までのいずれかに該当する物資を操作し、保守し又は点検するために設計したプログラム
⑽　19から21まで若しくは40のいずれかに該当する物資を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術
⑾　23⑴若しくは⑹若しくは24のいずれかに該当する物資を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術
⑿　ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは４に該当する物資を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術
⒀　ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機を使用するために設計したプログラムであって、２つ以上の物資（４⑴に該当するものに限る。）の機能を調整することができるもの（⑶に該当するものを除く。）
⒁　ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であって、電磁パルス又は電磁障害の影響を防止するための技術
⒂　ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットの軌道を最適化するために、飛行制御、誘導又は推進に係るデータを飛行管理装置に統合するための技術
⒃　飛行時に記録されたデータを処理して飛行時の全経路にわたる機体の位置決定を可能にするプログラム（ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術
⒄　オートクレーブの使用に係る技術であって、オートクレーブ内部の環境を規定するためのデータ又は手順（22（⑶及び⑻を除く。）に該当する物資を使用するためのものに限る。）
⒅　原料ガスの熱分解（1,300度以上2,900度以下の温度範囲において、かつ、130パスカル以上20,000パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。）により生成する物質を基材に定着させるための技術